



台積公司董事會決議

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2023年5月9日

台灣積體電路製造股份有限公司今（9）日召開董事會，重要決議如下：

- 一、核准配發 2023 年第一季之每股現金股利 3.00 元，其普通股配息基準日訂定為 2023 年 9 月 20 日，除息交易日則為 2023 年 9 月 14 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2023 年 9 月 16 日起至 9 月 20 日止，停止普通股股票過戶，並於 2023 年 10 月 12 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2023 年 9 月 14 日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為 2023 年 9 月 15 日。
- 二、核准資本預算約美金 3 億 6,610 萬元，以進行廠房興建及廠務設施工程。
- 三、核准於不高於新台幣 600 億元之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。
- 四、核准本公司「公司治理政策」。
- 五、核准擢升本公司晶圓廠營運一組織十八 A 廠資深廠長莊瑞萍先生為副總經理。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企业公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2022 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 288 種製程技術，為 532 個客戶生產 1 萬 2,698 種不同產品。台積公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長

Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係處主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

李國維
企業公共關係處
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: baker_li@tsmc.com